



平成 21 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 大日本スクリーン製造株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 橋本 正博
(コード番号 7735 東証・大証 第1部)
問 合 せ 先 経理戦略室長 巽 光司
TEL (075) 414 - 7155

株式会社 SOKUDO の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 6 月 23 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社 SOKUDO（以下 SOKUDO 社）の株式を取得し、子会社化することを決議しましたのでお知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

アプライドマテリアルズ社（Applied Materials, Inc.、本社米国カリフォルニア州、以下 APPLIED 社）と当社とのジョイントベンチャーによる SOKUDO 社設立から約 3 年が経過いたしました。SOKUDO 社は、当社から半導体関連コータ・デベロッパ（塗布現像装置）事業部門を分割・設立した会社であり、APPLIED 社との業務・資本提携により、これまで共同支配企業として運営してまいりました。この間、SOKUDO 社は、両社の強みを生かした新製品の開発を進め、平成 21 年 4 月に、高生産性を実現する世界初のデュアルトラックシステムを採用した次世代塗布現像装置「SOKUDO DUO」をリリースいたしました。

一方、半導体製造装置市場は、世界的な景気後退を受け低迷しており、当面厳しい状況が続くことが予想されます。このような環境のなか、SOKUDO 社におきましても、海外拠点を含む、販売・サービス体制の適正化、効率化等、組織のスリム化が急務であるとともに、新製品のリリースを受け、よりフレキシブルに市場の要求に応えることのできる体制の確立が求められています。

かかる状況のなか、両社協議の結果、今後の SOKUDO 社の事業価値向上、競争力強化のためには、当社の持つインフラの積極活用により規模の適正化を図るとともに、生産委託先である当社とのさらなる連携強化により従来以上にスピード感のある体制を確立していくことが不可欠と判断し、本件株式の取得（子会社化）を実施するものであります。

なお、今回の株式取得により、SOKUDO 社の株主構成は当社 81.0%、APPLIED 社 19.0%（従来は当社 52.0%、APPLIED 社 48.0%）となります。

2. 株式会社 SOKUDO の概要

(1) 名 称	株式会社 SOKUDO
(2) 所 在 地	京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 88 番地 K・I 四条ビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 須原 忠浩
(4) 事 業 内 容	半導体関連コータ・デベロッパに関する 開発、製造、販売、保守事業
(5) 資 本 金	90 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 18 年 7 月 3 日
(7) 大株主及び持株比率	大日本スクリーン製造株式会社 52.0% Applied Materials, Inc. 48.0%

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当該会社は当社および Applied Materials 社による共同支配企業であり、当社は当該会社の発行済株式総数の 52.0%を保有しております。	
	人的関係	平成 21 年 4 月 1 日現在、当社は当該会社に対し、代表取締役社長（非常勤）および取締役 2 名（非常勤）ならびに監査役 1 名（非常勤）を派遣しております。また、当該会社の従業員のうち、119 名が当社からの出向社員であります。	
	取引関係	当社は当該会社から半導体関連コータ・デベロッパの生産を受託しております。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成 19 年 3 月期 (9 ヶ月)	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期
連結純資産	23,737 百万円	16,195 百万円	4,505 百万円
連結総資産	38,551 百万円	28,608 百万円	12,952 百万円
連結売上高	23,144 百万円	22,555 百万円	12,264 百万円
連結当期純利益	△1,975 百万円	△7,602 百万円	△11,687 百万円

3. Applied Materials 社（株式取得の相手先）の概要

(1) 名称	Applied Materials, Inc.
(2) 所在地	3050 Bowers Avenue, Santa Clara, California 95054 United States of America
(3) 代表者の役職・氏名	Michael R. Splinter (Chairman of the Board, President and CEO)
(4) 事業内容	半導体、フラットパネル、太陽電池関連市場に製造装置、サービス、ソフトウェア製品など Nanomanufacturing Technology™ソリューションを幅広く提供
(5) 設立年月日	1967 年 11 月 10 日
(6) 株主資本	7,095,899 千米ドル (2009 年 4 月 26 日現在の Total stockholders' equity)
(7) 総資産	9,749,099 千米ドル(2009 年 4 月 26 日現在)
(8) 大株主及び持株比率	FMR LLC 15.0% (2009 年 2 月 17 日現在) Capital World Investors 9.1% (2009 年 2 月 13 日現在)
(9) 上場会社と当該会社の関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的・資本関係等はありません。

4. 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	520 株 (所有割合 : 52.0%)
(2) 取得株式数	290 株
(3) 異動後の所有株式数	810 株 (所有割合 : 81.0%)

5. 日 程

(1) 取締役会決議	平成21年6月23日
(2) 株式取得日	平成21年6月23日

6. 連結損益に与える影響および今後の見通し

本件、株式取得により、SOKUDO 社は共同支配企業（持分法に準じた会計処理適用の関連会社）から当社の子会社となるため、SOKUDO 社およびその100%子会社 SOKUDO USA, LLC の2社を新たに連結の範囲に含める予定です。

また、当社は、改正後の企業結合に関する会計基準等を平成22年3月期より適用し、本件 SOKUDO 社の連結子会社化に際し、約52億円の特別利益（段階取得に係る差益ならびに負ののれん発生益）を計上する予定です。

なお、平成22年3月期の連結業績見通しにつきましては、実行中の再建策の効果および本件 SOKUDO 社の連結子会社化による影響を含め、現在算定中であります。開示が可能になった時点で、速やかに開示いたします。

以 上